

目录

1 范围	1	5.4.1 概述	8
1.1 目的	1	5.4.2 输入	8
1.2 本文件目标	1	5.4.3 任务	8
1.3 文件限制	1	5.4.4 输出	9
2 适用文件	1	5.5 首次构建支持	9
2.1 IPC	1	5.5.1 概述	9
2.2 SAE International	2	5.5.2 输入	9
2.3 IEEE	2	5.5.3 任务	9
2.4 JEDEC	2	5.5.4 输出	9
2.5 政府机构	2	5.6 产品验证	9
3 术语及定义	3	5.6.1 概述	9
4 卓越设计 (DFX) 实践概述	4	5.6.2 输入	9
4.1 可制造性设计 (DFM)	4	5.6.3 任务	9
4.2 印制板可制作性设计 (DFP)	4	5.6.4 输出	9
4.3 可组装性设计 (DFA)	5	5.7 支持	10
4.4 测试 / 可测试性设计 (DFT)	5	5.7.1 概述	10
4.5 成本设计 (DFC)	5	6 板组装过程	10
4.6 可靠性设计 (DFR)	5	6.1 范围	10
4.7 环境设计 (DFE)	6	6.2 阻焊膜	10
4.8 重用性设计	6	6.3 元器件	10
5 印制板组件设计过程	6	6.4 拼板 / 排列	10
5.1 概述	6	6.5 间隙	10
5.2 概念设计与分析	6	6.6 元器件放置 / 贴装	11
5.2.1 概述	6	6.7 热焊盘排气	11
5.2.2 输入	7	6.8 基准点	12
5.2.3 任务	7	6.9 工装	12
5.2.4 输出	7	6.10 无铅焊料组装温度	12
5.3 详细设计	7	6.10.1 灌铜和热隔离	12
5.3.1 概述	7	6.10.2 热敏元器件	12
5.3.2 输入	7	6.10.3 组装对印制板组件材料的影响	13
5.3.3 任务	8	6.10.4 湿气敏感度	13
5.3.4 输出	8	6.11 表面贴装焊膏印制	13
5.4 设计发布	8	6.12 机器焊接	13
		6.12.1 单点自动焊接系统	13
		6.12.2 再流焊接	13
		6.12.3 对流再流	13

